

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第3部門第3区分
【発行日】平成18年8月10日(2006.8.10)

【公開番号】特開2001-19928(P2001-19928A)
【公開日】平成13年1月23日(2001.1.23)
【出願番号】特願平11-193829
【国際特許分類】

C 0 9 J 163/00 (2006.01)

C 0 9 J 183/04 (2006.01)

H 0 1 L 21/52 (2006.01)

【F I】

C 0 9 J 163/00

C 0 9 J 183/04

H 0 1 L 21/52 E

【手続補正書】

【提出日】平成18年6月23日(2006.6.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 平均粒径が10～100 μ mであり、かつ、長短径比が1.0～1.5である球状充填剤を重量単位で1～900ppm含有する硬化性ポリマー組成物からなることを特徴とする、半導体チップを該チップ取付部材に接合するための接着剤。

【請求項2】 球状充填剤の粒径分布の標準偏差が、該充填剤の平均粒径の10%以内であることを特徴とする、請求項1記載の接着剤。

【請求項3】 球状充填剤が無機質球状充填剤であることを特徴とする、請求項1記載の接着剤。

【請求項4】 硬化性ポリマー組成物が硬化性シリコン組成物であることを特徴とする、請求項1記載の接着剤。

【請求項5】 硬化性ポリマー組成物が硬化性エポキシ樹脂組成物であることを特徴とする、請求項1記載の接着剤。

【請求項6】 請求項1乃至5のいずれか1項に記載の接着剤により半導体チップを該チップ取付部材に接合してなることを特徴とする半導体装置。